

中华人民共和国国家标准

GB/T 15157.12-2011/IEC 60603-12:1992

频率低于 3 MHz 的印制板连接器 第 12 部分:集成电路插座的尺寸、 一般要求和试验方法详细规范

Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards—
Part 12: Detail specification for dimensions, general requirements and tests for a range of sockets designed for use with integrated circuits

(IEC 60603-12:1992, IDT)

2011-12-30 发布 2012-07-01 实施

目 次

前	ii ·······
1	范围
2	规范性引用文件
3	IEC 型号命名 ······ 2
4	通用特征
5	尺寸
6	特性
7	试验一览表
8	具有贯通板插入焊接接端的双列直插式插座(标准型)
9	具有贯通板插入非焊绕接接端的双列直插式插座(标准型)
10	具有贯通板插入焊接接端的双列直插式插座(小外壳型)
11	具有贯通板插入非焊绕接接端的双列直插式插座(小外壳型)
12	单脚接触件保持力标准规
13	插座标准规

前 言

GB/T 15157《频率低于 3 MHz 的印制板连接器》分为 14 个部分:

- ——第1部分:总规范 一般要求和编制有质量评定的详细规范的导则
- ——第2部分:有质量评定的具有通用安装特征 基本网格为2.54 mm(0.1 in)的印制板用两件式 连接器详细规范
- ——第3部分:接触件中心间距和交错排列的引出端中心间距均为2.54 mm 的两件式连接器详细规范
- ——第4部分:接触件中心间距和交错排列的引出端中心间距均为1.91 mm 的两件式连接器详细规范
- ——第5部分:间距为2.54 mm的双面印制板刀叉式插座连接器和两件式连接器详细规范
- ——第6部分:标称厚度为1.6 mm 的单面或双面印制板用接触件间距为2.54 mm 的刀叉式插座 连接器和印制板连接器详细规范
- ——第7部分:有质量评定的具有通用插合特性的8位固定和自由连接器详细规范
- ——第8部分:有0.63 mm×0.63 mm 方形阳接触件 基本网格为2.54 mm 两件式印制板连接器 详细规范
- ——第 9 部分:基本网格为 2.54 mm 的背面板和电缆连接器,两件式印制板连接器详细规范
- ——第 10 部分:方向型基本网格为 2.54 mm 的两件式印制板连接器详细规范
- ——第 11 部分:同轴连接器详细规范(自由连接器和固定连接器的尺寸)
- ——第12部分:集成电路插座的尺寸、一般要求和试验方法详细规范
- ——第 13 部分:自由连接器为非绝缘位移引出端 有质量评定的基本网格为 2.54 mm 的两件式 印制板连接器详细规范
- ——第 14 部分:音频、视频和音像设备用低音频及视频圆形连接器详细规范

本部分是 GB/T 15157《频率低于 3 MHz 的印制板连接器》的第 12 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分等同采用 IEC 60603-12:1992《频率低于 3 MHz 的印制板连接器 第 12 部分:集成电路插座的尺寸、一般要求和试验方法详细规范》。

本部分对 IEC 60603-12:1992 作了下列编辑性修改:

- a) 删除 IEC 60603-12:1992 中的前言。
- b) 在引用文件中增加 GB/T 5095.1—1997 和 GB/T 5095.8—1997。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用机电元件标准化技术委员会(SAC/TC 166)归口。

本部分起草单位:中国电子技术标准化研究所、浙江省长兴电子厂、厦门迈士通电器股份有限公司、 深圳市瑞松电器有限公司。

本部分主要起草人:陈奥、曹宏国、罗小庆、郑昆和、何曙晖、汪其龙。

频率低于 3 MHz 的印制板连接器 第 12 部分:集成电路插座的尺寸、一般要求和试验方法详细规范

1 范围

本部分规定了双列直插式集成电路(见 IEC 60191-2:1966 中的规定,如 A-50)插座的尺寸、一般要求和试验方法。

插座包括标准型(见图 6 和图 7)和小外壳型(见图 8 和图 9)。

本部分适用于具有贯通板插入接端的插座预定用于符合 GB/T 1360—1998 规定的基本网格为 2.54 mm(0.1 in)的印制板。

小外壳型插座在 2.54 mm(0.1 in)网格上可侧面对侧面和端头对端头安装。

本部分不包括试验用老炼插座。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1031—2009 产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 1360—1998 印制电路的网格体系(idt IEC 60097:1991)

GB/T 5095.1—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 第 1 部分: 总则 (idt IEC 60512-1:1994)

GB/T 5095.2—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 第2部分:一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验(idt IEC 60512-2:1994)

GB/T 5095.3—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第3部分:载流容量试验(idt IEC 60512-3:1976)

GB/T 5095.4—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第4部分: 动态应力试验(idt IEC 60512-4:1976)

GB/T 5095.5—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 第5部分: 撞击试验 (自由元件)、静负荷试验(固定元件)、寿命试验和过负荷试验(idt IEC 60512-5:1992)

GB/T 5095.6—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第6部分:气候试验和 锡焊试验(idt IEC 60512-6:1984)

GB/T 5095.7—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 第7部分:机械操作试验和密封性试验(idt IEC 60512-7:1993)

GB/T 5095.8—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 第8部分:连接器、接触件及引出端的机械试验(idt IEC 60512-8:1993)

IEC 60191-2:1966 半导体器件的机械标准化 第 2 部分:尺寸(Mechanical standardization of semiconductor devices—Part 2:Dimensions)